



IJPR[®]

インクジェット用絶縁材料 Dielectrics for Ink-jet

デュアルキュア（UV・熱併用）方式の一液性絶縁材料
Dual-curing system (UV+thermal) one-component type dielectric material

- **イミド系樹脂とアクリレートモノマーの併用で低粘度と高信頼の両立**
Achieved high reliability with low-viscosity by using combination of imide-resin and acrylate monomer
- **無溶剤タイプ** Solvent free
- **塗布直後に UV 照射することで、パターン形状を保持し、熱硬化時のにじみを防ぐ**
Prevent bleeding during thermal curing step by rapid UV cure applied just after printing process in order to keep good pattern shape
- **各種材料に密着（金属、イミド、ガラス等）**
Excellent adhesion with various material (metal, imide, glass, etc)
- **マイグレーション耐性が非常に優れたリジッドタイプと可とう性のあるフレキタイプの 2 種**
2 versions available : rigid type with high migration resistance, flex type with high bendability
- **一液性でクリアタイプ 常温での保存も可能で、加熱ヘッドにも対応**
One-component, transparent, R.T. storage, compatible to heat-head type
- **粘度 30mPa·s (25℃)** Viscosity 30mPa·s (25℃)

プロセス Process



関連特許
登録

中国: ZL200480012609.5 台湾: I288142 韓国: 10-890086 米国: 7462653
EP: 1624001 (英、仏、独、スイス、フィンランド), 1857478 (英、独、スイス、オーストリア)

出願中

W02004/099272 (日本、韓国) W02006/075654 (日本、米国、中国、韓国)